

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：临 2020-099

## **博敏电子股份有限公司**

### **关于完成工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 11 月 24 日，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）就公司本次非公开发行 A 股股票的股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，此次发行股份登记完成后，公司总股本由 441,053,596 股变更为 511,012,097 股，公司注册资本由人民币 441,053,596 元增加至 511,012,097 元。

2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据本次发行股票结果，增加注册资本、对《公司章程》有关条款进行修改，并办理相关工商变更登记。2020 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博敏电子股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2020-090）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并领取了梅州市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：

统一社会信用代码：914414007730567940

名称：博敏电子股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：梅州市经济开发试验区东升工业园

法定代表人：徐缓

注册资本：人民币伍亿壹仟壹佰零壹万贰仟零玖拾柒元

成立日期：2005 年 03 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：研发、制造、销售：双面、多层、柔性、高频、HDI 印刷电路板等新型电子元器件；电路板表面元件贴片、封装；货物的进出口、技术进出口；投资；不动产及机器设备租赁；软件的设计、开发、技术服务和咨询；网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售；电子材料的研发、生产和销售；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日